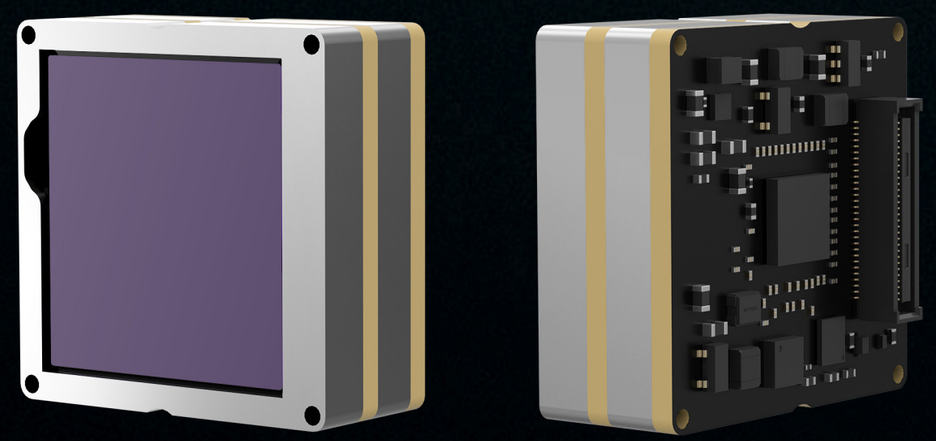
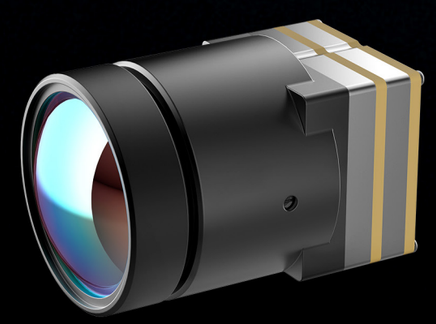
Infrared Camera Core

机芯模组

机芯采用高可靠性的 640x512 分辨率红外探测器，具备了良好的抗震防冲击能力；自主研发从镜头、探测器到结构等核心部件，具有技术安全、自主可靠性；兼具软硬件一体化协同设计，有效补偿能量漂移的特性，能最大限度地保证了成像清晰和画质流畅；支持多种接口的定制化能力，提供多种规格的红外镜头选配，可满足多种应用场景。机芯凭借出色的性能、稳定的结构和灵活的可配置性，适用于各领域红外热成像设备 / 系统的开发及集成、各类成像整机、光电系统的集成，可以应用干车载夜视、安防监控，户外运动、消防救援、执法搜救等领域。



- 探测器灵敏度高，成像清晰
- 多种标准接口，易于二次开发集成
- 高性能设计，结构稳定，适应各种严苛环境
- 多规格镜头可选和接口模块定制化，满足个性化需求
- 高帧频，满足高速移动目标观察画面流畅不卡顿



Infrared Camera Core

探测器性能		
探测器类型	氧化钒	
像素	384*288	640*512
像元间距	12μm	
噪声等效温差	≤ 50mK，@F1.0，300K	
帧频	≤ 60Hz	≤ 50Hz
响应波段	8 ~ 14μm	
图像功能		
亮度对比度调整	自动 / 手动	
电子放大	X1	
十字分划	显示 / 消隐 / 移动	
伪彩	白热、黑热、铁红、彩虹、反铁红、羽红	
图像处理	非均匀性校正、数字滤波降噪、数字细节增强	
电源		
电源保护	支持过压、欠压和反接保护	
电源输入	DC 3.6 ~ 5.5V	
功耗	≤ 1.5W	
环境参数		
振动	6.06g，随机振动，所有轴向	
冲击	80g，4ms，后峰锯齿波，3 轴 6 向	
湿度	5 ~ 95%，无冷凝	
工作温度范围	-40°C~+55°C	
存储温度范围	-55°C~+70°C	
镜头选项		
焦距	9/13/19/25/35/50mm，F1.0	
调焦方式	手动	
视场角	69.3° X 55.4°（9mm） 48.0° X 38.4°（13mm） 32.8° X 26.3°（19mm） 24.9° X 20.0°（25mm） 17.8° X 14.3°（35mm） 12.5° X 10°（50mm）	
接口		
模拟视频	CVBS	
数字视频	BT.656/LVDS/MIPI/Cameralink/SDI/ETH(可选)	
通讯接口	UART/12C	
物理参数		
重量	<160g 以下（不含镜头）	
尺寸	25mm X 25mm X 18.5mm（不含镜头）	